

Press release

2016年1月6日

ヘンケルジャパン「第2回ウェアラブルEXPO」に出展

～電子・電気部品を絶縁封止する低圧射出成形工法ホットメルトモールディングを提案～

ドイツの化学・消費財メーカー ヘンケルの日本法人ヘンケルジャパン株式会社(本社:東京都品川区、社長:玉置 眞)のエレクトロニクス事業部は、「第2回ウェアラブルEXPO ～ウェアラブル端末の活用と技術の総合展～」(会期:2016年1月13日～15日 会場:東京ビッグサイト)に出展いたします。

ヘンケルジャパンブースでは、ウェアラブル端末に求められる小型軽量化を実現する低圧射出成形工法 ホットメルトモールディングを提案、TECHNOMELT(テクノメルト)ホットメルト樹脂の展示および成形機を用いたモールディングのデモンストレーションを行います。本工法は、環境に配慮した無溶剤化および作業環境の向上という要望を満たすと同時に、生産性の向上によりコストダウンを実現することが可能です。ヘンケルジャパンでは、樹脂の選定から試作、協力設備メーカーによる量産導入にいたるまで、トータルサポートを提供しております。

その他、熱伝導材料、低温硬化アンダーフィル剤、60℃硬化 エポキシ接着剤などを出品、グローバルトップシェアの接着剤メーカーとして、お客様へ最適なソリューションを総合的に提案いたします。

<ヘンケルジャパン 出展製品>

TECHNOMELT(テクノメルト) 低圧射出成形工法 ホットメルトモールディング

ホットメルト接着剤を成形材料に使用することで、電子・電気部品を絶縁封止し、湿気等の外的環境から保護します。ホットメルト用低圧成形機も展示・実演します。



LOCTITE(ロックタイト)低温硬化アンダーフィル剤

PCB(プリント回路基板)を熱衝撃、湿気、腐食性物質などのさまざまな悪条件から保護し、過酷な条件下でのウェアラブル機器の長寿命化に役立ちます。

LOCTITE(ロックタイト)60℃硬化 エポキシ接着剤

独自の技術である潜在性硬化剤を使用することで、60℃という非常に低温での硬化を実現。熱に対して脆弱な部品、プラスチックなどの構造物への補強用途など、幅広い用途に使用できます。

BERGQUIST(パーキスト)熱伝導材料 Gap Filler / Gap Pad® / Gap Pad® EMI 1.0

Gap Filler は、2液混合タイプの熱伝導性ギャップ充填材料であり、ディスペンサーで塗布できるため形状自由度が高く、組立時に部品や基板に負荷がかからず、応力が発生しません。

ディスペンサー装置も展示・実演します。

一方、GapPad®は、高さの異なる様々な部品が実装された基板を、筐体フレームや大型ヒートシンクなどと直接熱的に接合することが可能です。また、熱伝導性とEMI(電磁波ノイズ)吸収性を併せ持つGap Pad® EMI 1.0もパネル展示いたします。



<展示会概要>

名称:「第2回ウェアラブルEXPO ～ウェアラブル端末の活用と技術の総合展～」

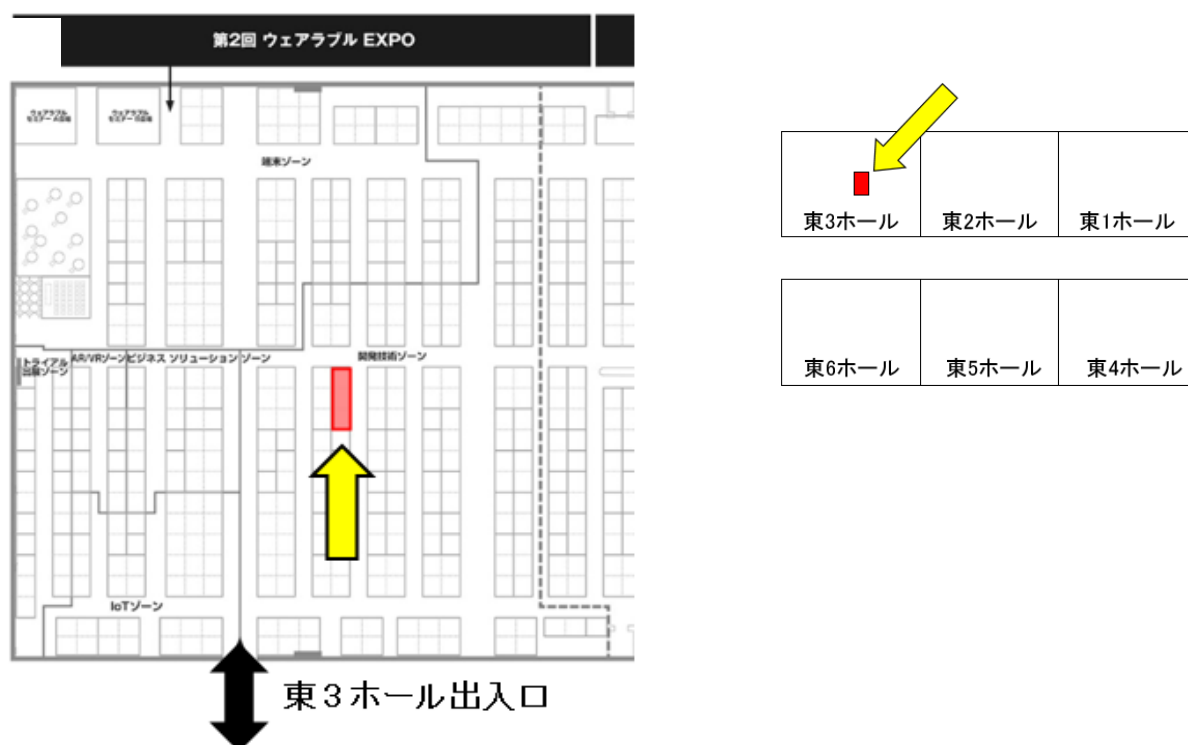
会期:2016年1月13日(水)～15日(金) 10:00～18:00(最終日のみ17:00終了)

会場:東京ビッグサイト東ホール

主催:リードエグジビション ジャパン株式会社

概要:業務改善のためのウェアラブルソリューションから、IoT、AR/VR技術、最新ウェアラブルデバイス開発のための部品・材料まで、ウェアラブルに関する世界最大の専門展。

<ヘンケルジャパン小間番号:東3ホール E23-20>



ヘンケルについて

ヘンケルはブランドとテクノロジーのグローバルリーダーとして、ランドリー&ホームケア、ビューティーケア、アドヒーズブテクノロジー(接着技術)の3つの分野で事業展開をしています。ヘンケルは1876年の創立以来、コンシューマービジネスおよび産業分野において、Persil(パーシル)、Schwarzkopf(シュワルツコフ)、Loctite(ロックタイト)などに代表される有名なブランドの数々と共に、グローバルにおけるマーケットリーダーとしての地位を維持しています。ヘンケルの従業員数は約50,000人であり、2014年度の売上高は164億ユーロ、調整後の営業利益は26億ユーロを計上しました。ヘンケルの優先株はドイツ株式指数DAXのリストに入っております。

ヘンケルジャパンホームページ: <http://www.henkel.co.jp>

ヘンケルジャパンフェイスブックページ: <http://www.facebook.com/HenkelJapan>

—本件に関するお問合せ先—
ヘンケルジャパン株式会社 接着技術事業部門
マーケティング部 担当:清晴世
TEL:045-758-1784 e-mail:haruyo.sei@henkel.com